

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州锴威特半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目录

目录.....	1
一、发行人基本情况.....	2
二、申请上市股票的发行情况.....	14
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况.....	15
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明.....	16
五、保荐机构承诺事项.....	17
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.....	18
七、保荐机构针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，及保荐机构的核查内容和核查过程的说明.....	19
八、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明.....	23
九、发行人表决权差异安排情况.....	25
十、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.....	25
十一、其他说明事项.....	26
十二、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论.....	26

华泰联合证券有限责任公司关于 苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“发行人”“锴威特”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

- 1、公司名称：苏州锴威特半导体股份有限公司
- 2、注册地址：张家港市杨舍镇沙洲湖科创园 A1 幢 9 层
- 3、有限公司成立日期：2015 年 1 月 22 日
- 4、整体变更设立股份公司日期：2019 年 7 月 30 日
- 5、注册资本：人民币 5,526.3158 万元
- 6、法定代表人：罗寅
- 7、联系方式：0512-58979952

8、业务范围：半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；软件设计、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、主营业务

公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，主要产品包含功率器件及功率 IC 两大类。在功率器件方面，公司产品以高压平面 MOSFET 为主，并在平面 MOSFET 工艺平台基础上设计研发了集成快恢复高压功率 MOSFET（FRMOS）系列产品；在功率 IC 方面，公司专注于功率驱动 IC 和电源管理 IC。此外，在第三代半导体方面，公司的 SiC 功率器件已小批量出货。

公司是国家高新技术企业、国家鼓励的重点集成电路设计企业、江苏省“科技小巨人企业”“江苏省潜在独角兽企业”、江苏省半导体行业协会理事单位，公司研发中心获“江苏省高可靠性功率器件工程技术研究中心”认证。截至本上市保荐书出具日，公司已积累了 10 项核心技术，获得 50 项授权专利（其中发明专利 8 项，实用新型专利 42 项，另有 1 项发明专利已获授予专利通知书，待取得专利证书）和 32 项集成电路布图设计专有权。

凭借高性能的产品，公司荣获由中国电子信息发展研究院（赛迪研究院）评选的第十六届（2021 年度）和第十五届（2020 年度）“中国芯”优秀技术创新产品奖；由中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会等机构联合评选的第十四届（2019 年度）和第十二届（2017 年度）中国半导体创新产品和技术奖。公司还获得了汉磊科技“最佳合作伙伴”“最佳业绩成长”的合作商奖项，芯片设计和工艺调试能力得到业内知名晶圆代工厂的认可。

凭借产品可靠性高、参数一致性好等特点，公司迅速在细分领域打开市场，产品广泛应用于消费电子、工业控制及高可靠领域，客户包括以晶丰明源、必易微、芯朋微、灿瑞科技为代表的芯片设计公司等多家高可靠领域客户，并且产品已被小米、美的、雷士照明、佛山照明等终端客户所采用。

根据 Omdia 数据，按 2020 年收入规模测算，公司在全球 MOSFET 功率器件市场份额约为 0.23%。根据江苏省半导体行业协会统计，2020 年公司 FRMOS 产品国内市场占有率在本土企业中排名第四位。

2、核心技术和研发水平

发行人核心技术主要如下所示：

序号	技术名称	技术来源	技术特点	应用产品	对应专利
1	高压 MOSFET 的少子寿命控制技术及其工艺实现技术	自主研发	通过控制重金属掺杂浓度，控制硅中的少子寿命，技术整体达国际先进水平。利用该技术制造的 FRMOS 产品具有反向恢复时间短、漏电流小、高温特性好、反向恢复特性较软、低电磁干扰的产品特性，性能优于利用电子辐照技术制造的同类产品。	FRMOS	非专利技术
2	新型复合终端结构及实现工艺技术	自主研发	采用横向变掺杂和场板复合的终端结构，使终端表面电场分布更加均匀，降低产品的高温漏电流，提高产品可靠性，技术整体达国际先进水平。应用该技术可将高压平面 MOSFET 的终端环尺寸减小 50%。	平面 MOSFET	非专利技术
3	一种防止自掺杂的背封结构	自主研发	发行人研制的一种掺砷衬底防止自掺杂的背封结构，可以确保在 MOSFET 正面工艺过程中避免衬底对高阻外延层的自掺杂影响。技术整体达国际先进水平。相比使用铋掺杂衬底材料的制造工艺，该技术可取消薄片注入和退火的工序，有效降低碎片率，提升产品制造良率。	平面 MOSFET	非专利技术
4	高可靠性元胞结构	自主研发	采用 spacer 侧墙技术、浅槽孔技术及复合介质层工艺，实现了稳定可靠的高电流密度元胞结构，技术整体达国内领先水平。在同等工艺平台下，可达到更高的电流密度，实现更小的芯片面积。	平面 MOSFET	非专利技术
5	短沟道碳化硅 MOSFET 器件系列产品沟道控制及其制造技术	自主研发	1、常规方法利用两次光刻的尺寸差异来形成沟道，套刻偏差容易导致沟道离散，限制了沟道长度精度。该技术通过自对准工艺形成极短且一致性好的沟道长度，可在优化 Ronsp 参数的同时，确保器件参数的一致性和稳定性； 2、在碳化硅 MOSFET 器件中集成碳化硅肖特基二极管，从而改善碳化硅 MOSFET 的体二极管特性，用一颗器件可以替换系统应用中的碳化硅 MOSFET 和碳化硅二极管两颗器件并联，简化系统并降低系统成本。	SiC MOSFET	ZL202010005540.4 (另有 1 项发明专利 202010005171.9 在审中)
6	一种利用 Power MOS 管实现高压	自主研发	1、可利用功率 MOS 场效应管实现高压快速启动，具有启动时间短、成本低、待机功耗小等优点；	平面 MOSFET、电源管理	ZL201610936731.6 ZL201510756113.9 2 项发明专利已授权

序号	技术名称	技术来源	技术特点	应用产品	对应专利
	快速启动的AC-DC开关电源的实现方法		2、将高压MOS启动管、过热采样单元、过流采样单元同高压MOS开关管集成，降低了主控芯片的工艺难度，使各种保护功能更精准，响应速度更快。	IC	
7	基于SOI BCD工艺的设计平台	自主研发	基于合作晶圆代工厂的标准工艺平台，发行人对工艺条件持续优化，形成了基于0.5um SOI BCD工艺的设计平台，利用SOI工艺的低寄生、低漏电、闩锁免疫等优势，设计各种拓扑的电源管理芯片，包括反激、正激、有源钳位、SEPIC、级联、推挽、半桥等多种IP核，并在IP基础上成功开发了近20款功率IC产品。	电源管理IC、驱动IC	202110084048.5 202110083120.2 等6项发明专利在审中
8	一种全电压范围多基准电压同步调整电路、高精度过压保护电路及相对电源的高压稳压电路	自主研发	1、提供一种栅极氧化层烧写电路，可以在芯片封装后进行修调，避免了芯片制造、封装过程带来的误差，确保了产品参数的一致性； 2、实现2n位的电压调整档位，可输出全电压范围高精度多基准参考电压； 3、有效改善产品参数的一致性及过压保护的判决时间精度，提高过压保护的一致性。 4、提供一种相对电源的高压稳压电路，可以为电源管理和驱动IC内部模块供电提供一种灵活的供电方式。	电源管理IC、驱动IC	ZL201510712389.7 ZL201510712488.5 ZL202111106498.6 3项发明专利已授权
9	一种半桥驱动芯片电路设计及制造工艺	自主研发	可简化半桥驱动芯片的制造工艺，降低制造成本；采用恒流驱动的方式，可降低电路功耗，增强其可靠性。	驱动IC	ZL201510261101.9 ZL201510264870.4 2项发明专利已授权
10	一种输入失调电压自动修正电路	自主研发	实现电路在每次上电时都会对输入失调电压进行修正，消除外部环境对输入失调电压的影响。该技术方案下采用常规器件即可实现失调电压自动修正，比较器的输入失调电压可以达到微伏级别。	电源管理IC	201910540692.1 202011402062.7 202111106438.4 3项发明专利在审中（其中202111106438.4已收到《授予发明专利权通知书》，待取得专利证书）

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

主要财务指标	2021.12.31 /2021年度	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度
流动比率	2.94	2.69	2.26
速动比率	2.32	2.27	1.72
资产负债率（母公司）	29.76%	36.28%	42.05%

主要财务指标	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
应收账款周转率（次）	8.17	4.52	4.12
存货周转率（次）	2.57	3.79	4.14
息税折旧摊销前利润（万元）	5,286.69	-1,759.29	1,132.01
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,847.72	-1,966.86	933.81
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4,389.76	-179.75	450.76
研发投入占营业收入的比例	8.99%	10.14%	7.23%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.92	-0.20	-1.49
每股净现金流量（元/股）	1.75	1.13	1.10

注：指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

归属于发行人股东的净利润=归属于母公司股东的净利润；

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于母公司股东的净利润-非经常性损益的影响数；

研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入；

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（四）发行人存在的主要风险

1、技术风险

1) 新产品研发不及预期的风险

半导体行业的研发存在周期较长、工艺复杂等特点，产品技术优化升级需要持续的资源投入，未来公司将继续加大新型功率器件、功率 IC 产品的研发力度。

由于半导体行业研发项目的周期较长，相关研发项目进度和研发成果产业化都具有不确定性，如果产品研发进度未达预期或无法在市场竞争中占据优势，公司将面临新产品研发失败的风险，前期的研发投入也将无法收回；若公司未来研发投入不足，则可能致使公司现有技术被赶超或产品被替代，进而导致公司已有

产品的市场竞争力下降，给公司未来业务拓展带来不利影响。

2) 技术泄密的风险

基于多年的技术积累和研发投入，公司在功率半导体领域已形成多项核心技术，并已将核心技术广泛应用于自有产品中。目前，公司正致力于新技术和新产品的研发。如果公司核心技术人员流失或个别人员核心资料保管不善，则可能导致公司核心技术失密的风险。若公司核心技术泄密，并被竞争对手所获知和模仿，则可能会削弱公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。

2、经营风险

1) 下游需求及产品销售价格下滑的风险

公司主要产品为功率半导体，广泛应用于消费电子、工业控制、高可靠领域等下游行业。半导体行业具有较强的周期性特征，如果出现国内功率半导体国产替代趋势放缓、宏观经济或下游行业规模增速放缓或出现下滑、国家相关产业政策调整、市场竞争加剧、新型冠状病毒肺炎疫情持续、公司技术研发及市场开拓不及预期、公司未及时根据下游需求调整研发方向与经营策略等不利情形，可能导致下游市场对公司产品需求萎缩、销售价格下降，从而对公司的业绩造成一定不利影响。

2) 产品收入结构较为单一的风险

报告期内，公司实现大规模销售的主要产品为平面 MOSFET，该产品收入占主营业务收入的比例分别为 86.71%、88.39%和 83.07%，单一产品类别收入的占比较高。研发新产品并最终实现大规模销售有一定的时间周期，如果未来公司新产品研发不及预期、市场竞争加剧或下游市场波动，导致平面 MOSFET 的产品价格或市场需求增速出现下降，将会对公司的营业收入和盈利能力造成不利影响。

3) 新型冠状病毒疫情持续风险

2020年以来，国内外各地陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情并一直持续至今。公司作为采用 Fabless 经营模式的芯片设计公司，若上游供应商受到疫情影响，

无法维持生产能力进而无法及时供货，或者物流受疫情影响无法及时交货，或者下游需求出现阶段性减缓或停滞，都将对公司经营活动和业绩造成不利影响。若全球疫情短期内无法得到有效控制或国内疫情出现反复，可能对公司经营业绩造成不利影响。

4) 市场竞争风险

目前，我国的功率半导体行业正经历快速发展阶段，随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及智能装备制造、物联网、新能源等新兴领域的兴起，国内对功率半导体产品的需求迅速扩大，推动了行业的快速发展。我国目前已成为全球最大的功率半导体市场，并保持着较快的发展速度，这吸引了诸多国内企业进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时推出新产品、不断优化产品性能与提高服务质量，则可能导致公司竞争能力下降，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

5) 供应商集中度较高的风险

目前，公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的设计、研发和销售环节，而将晶圆制造、封装测试等生产环节委托供应商进行。由于资金、技术等壁垒，半导体行业内符合公司技术和工艺要求的晶圆代工厂数量较少。报告期内，公司向前五大供应商采购额占当期总采购额的占比分别为 89.74%、91.41% 和 76.55%，其中第一大供应商采购额占当期总采购额的占比分别为 51.68%，42.40% 和 34.98%，供应商集中度较高。报告期内，随着下游需求持续扩张以及新冠疫情对全球晶圆代工行业产能带来的负面影响，晶圆代工行业普遍出现产能紧张的情况。若未来公司主要供应商出现产能受限、自身生产经营或与公司合作情况发生不利变化等情况，公司在短时间内替换供应商存在较大困难，可能导致公司不能足量、及时出货，从而对公司生产经营造成不利影响。

6) 产业政策变化的风险

半导体产业作为信息产业的基础，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近

年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强中国半导体产业创新能力和国际竞争力。2018年，国家统计局发布了《战略新兴产业分类（2018）》，将“半导体分立器件制造”“集成电路设计”“金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）”等列为战略新兴产业。此外国家还持续推出了各项支持半导体行业发展的政策，包括《中国制造2025》《国家信息化发展战略纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（“十四五规划”）等。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营业绩可能会受到不利影响。

7) 晶圆供应及委外加工风险

目前，公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的设计、研发和销售环节，而将晶圆制造、封装测试等生产环节委托供应商进行。若晶圆代工、封装测试等委外加工价格大幅上涨，或因晶圆代工厂、封装测试厂产能紧缺或工艺波动等原因影响公司产品供给，将对公司供应稳定性、盈利能力造成不利影响。

8) 经营规模较小风险

报告期内，公司与同行业可比公司相比，经营规模较小，抵御市场波动风险的能力较弱。如果未来市场情况发生不利变化，或者竞争对手利用其品牌、技术、资金优势，加大在公司所处市场领域的投入，可能对公司市场份额形成挤压，从而影响公司的收入规模和盈利能力，对公司经营业绩造成不利影响。

9) 关于与西安微晶微的扩产合作风险

2021年，公司与西安微晶微签署了《扩产合作协议》，公司购置价值7,377.06万元（含税）的晶圆加工设备并投放于西安微晶微生产线，以锁定并进一步扩大晶圆产能供给。根据协议约定，扩产完成后，西安微晶微将保证向公司提供不低于18,000片/月的晶圆代工产能供给。前述扩产合作可能存在以下风险：一方面，如该批设备无法及时到位或设备调试进度不及预期，可能导致公司产能无法及时得到补充，进而对公司供应稳定性、盈利能力造成不利影响；另一方面，如未来市场发生波动导致公司下游需求减小，导致公司向西安微晶微采购晶圆数量下降，

则该批设备的摊销费用将导致晶圆成本较目前有所上涨，如公司无法向下游转嫁成本上涨的压力，则可能导致公司功率器件的盈利水平下降。

10) 国际贸易摩擦的风险

报告期内，公司存在向汉磊科技采购晶圆的情形。在经济全球化日益深化的背景之下，国际贸易关系的变化对于半导体行业景气度可能产生深远影响。一方面，近年来国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展；尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”。若美国将公司及公司主要客户、供应商列入“实体清单”名单或采取其他经济限制手段，可能导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到不利影响。另一方面，在国际贸易环境紧张的情况下，半导体产业链上下游可能出现生产和采购受限的情形，从而对公司经营业绩造成不利影响。

3、管理及内控风险

1) 关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险

在功率半导体行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司可以持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。目前国内半导体企业众多，对功率半导体关键技术人员需求缺口较大，运用高薪或者股权激励等方式吸引技术人员已逐渐成为行业内的常规手段，导致行业内人员流动愈发频繁。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人才发展及内部晋升受限，公司对关键技术人员的吸引力将减弱，甚至可能出现现有关键技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。

2) 控制权分散风险

本次发行前，实际控制人丁国华直接持有公司 20.26%的股份，并通过员工持股平台港晨芯控制公司 8.23%的表决权，根据已签署的《一致行动协议》，罗寅、港鹰实业、陈锴系丁国华的一致行动人。罗寅直接持有公司 17.09%股份，港鹰实业直接持有公司 10.11%股份，陈锴直接持有公司 7.24%股份。因此，丁国华直接和间接控制公司合计 62.93%的表决权。本次发行后，丁国华控制的股份

表决权比例将被稀释，不排除未来因不可控的因素可能影响公司控制权的稳定性，进而可能对公司未来经营造成不利影响。如未来实际控制人或其一致行动人通过二级市场减持等方式降低持股比例，或其他股东之间达成一致行动协议，或潜在的投资者收购公司股份导致公司其他股东持股比例增加从而超过丁国华控制的股权表决权比例，公司可能发生控制权转移的情形，进而可能导致公司在经营管理团队、核心技术人员、发展战略等方面发生较大变化，从而导致公司未来经营发展的不确定性。

3) 人员规模相对较小的风险

发行人作为采用 Fabless 经营模式的企业，将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给供应商，因此人员规模相对较小。报告期各期末，公司员工总人数分别为 56 人、71 人和 85 人，研发人员数量分别为 25 人、28 人和 32 人，相较 A 股已上市的同行业可比公司人数较少。若未来发生大规模人员流失的情况，将对发行人开展日常经营活动以及持续拓展业务规模带来不利影响。发行人研发人员数量较少，随着业务的发展，可能存在研发人才不足、研发进度不达预期的风险，进一步影响发行人新产品的推出、技术储备等方面，进而对公司未来业务发展造成不利影响。

4) 产品质量控制风险

公司产品的主要生产环节需委托供应商进行，产品质量受到加工流程中诸多因素的影响，而客户对产品一致性、可靠性要求较高。公司产品向新能源汽车、光伏能源、轨道交通、智能电网等高端应用领域拓展时也需满足更高的质量要求。随着发行人经营规模的持续扩大及客户对产品质量要求的不断提高，如果公司不能持续有效地完善、提升相关质量控制制度并严格执行质量控制措施，导致产品质量出现问题、产品质量不能达到客户需求，则产品不能满足下游客户的质量要求，影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4、财务风险

1) 收入高速增长不能持续的风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 10,575.54 万元、13,383.49 万元和

20,318.15 万元，2020 年和 2021 年同比分别增长 26.55%和 51.82%。报告期内，公司主营业务收入呈现较快增长。若未来半导体行业景气度下滑导致市场需求出现重大不利变化，或者市场竞争加剧导致公司不能保持产品的核心竞争力和市场竞争优势，进而对公司产品售价、销量造成负面影响，则可能会导致公司面临收入高速增长不能持续的风险。

2) 毛利率波动的风险

报告期内，公司的综合毛利率分别为 22.09%、17.84%及 39.53%，波动较为明显。公司综合毛利率受产品售价、产品成本以及产品结构等多种因素影响。随着市场需求的变化和行业技术的发展，若公司未能正确判断市场需求变化、技术水平停滞不前、未能有效控制产品成本或市场竞争格局发生不利变化，将会导致公司产品售价和成本出现预期外的波动，公司综合毛利率未来也可能会发生波动甚至出现下降。此外，公司产品规格较多，不同规格产品销售结构的变化亦会对公司的毛利率造成影响，从而对公司的生产经营带来一定的风险。

3) 存货减值的风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 2,848.79 万元、3,012.06 万元以及 6,694.00 万元，公司存货账面价值随着业务规模的增长及采购模式和产品销售形态的变化有所增加。公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的的影响，若未来市场环境发生变化、客户临时改变需求、竞争加剧或技术升级，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，导致产品滞销、存货积压，公司可能面临存货减值的风险，进而会对公司的盈利能力产生不利影响。

4) 无法持续取得税收优惠的风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策主要系“新办的集成电路设计企业”和“国家鼓励的重点集成电路设计企业”优惠税率税收优惠政策。根据相关政策规定，公司 2019 年、2020 年两年享受按照 25%的法定税率减半计缴企业所得税的优惠政策，2021 年享受免缴企业所得税的优惠政策，接续年度享受按照 25%的法定税率减按 10%计缴企业所得税的优惠政策。报告期内公司享受的所得税税收优惠金额占同期利润总额的比例分别为 7.81%、0.00%和 15.44%。若未来国家税

收优惠政策发生不利变化，或公司不符合税收优惠条件，将面临无法享受有关税收优惠政策的风险，将对公司的经营成果产生不利影响。

5、法律风险

1) 知识产权相关风险

公司拥有的知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。自设立以来，公司高度重视知识产权保护，截至本上市保荐书出具日，公司已获授权的专利 50 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 42 项；此外，公司还拥有多项非专利核心技术。未来，如公司相关核心技术被竞争对手所获知并效仿，或者第三方侵犯公司知识产权的行为得不到及时防范和制止，将会对公司未来业务发展和生产经营产生负面影响。此外，不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，或公司因其他原因与竞争对手或第三方产生知识产权纠纷，公司通过法律途径寻求保护将付出额外的人力、物力及时间成本，亦会导致公司商业利益、品牌声誉受到一定程度的损失。

2) 房屋租赁风险

因跨地区开展业务的需要，公司及子公司、分公司在张家港市、无锡市、西安市、深圳市等多地租赁了办公、研发场所等。租赁期限到期后，若上述房屋不能及时续租，公司或子公司、分公司需重新选择生产经营场所并进行搬迁，可能短期内对生产经营的稳定性造成不利影响。公司承租的部分员工宿舍未办理租赁备案登记，可能存在被所在地房地产主管部门处罚的风险。

6、本次发行失败的风险

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人中止发行上市审核程序超过上交所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，或将会出现发行失败的风险。

7、与募集资金运用相关的风险

1) 募集资金投资项目不能达到预期收益的风险

本次募集资金投资项目包括智能功率半导体研发升级项目、SiC 功率器件研发升级项目、功率半导体研发工程中心升级项目以及补充营运资金，本次募集资金投资项目与公司现有主营业务和发展战略紧密联系，现有的可行性分析是基于当前的市场环境和技术发展趋势等因素做出的，未来可能因产业政策变化、市场环境变化、行业竞争加剧或研发过程中关键技术未能突破等原因导致项目延期、无法实施或不能达到预期收益，将对发行人经营产生不利影响。

2) 募投项目实施带来的净资产收益率及每股收益下降风险

本次发行的募投项目投资金额较大且在短期内难以完全产生效益，募投项目实施后，公司将面临净资产收益率及每股收益下降的风险。本次募集资金投资项目建成后，公司将新增固定资产、无形资产、研发投入，导致相应的折旧、摊销及费用增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的折旧、摊销及费用支出将对公司的经营业绩产生不利影响。

二、申请上市股票的发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 1,842.1053 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,842.1053 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 7,368.4211 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		

发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
拟公开发售股份股东名称	无
发行费用的分摊原则	本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	智能功率半导体研发升级项目
	SiC 功率器件研发升级项目
	功率半导体研发工程中心升级项目
	补充营运资金
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元
(二) 本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况

(一) 保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为薛峰和牟晶。其保荐业务执业情况如下：

薛峰先生，硕士，保荐代表人，中国注册会计师，供职于华泰联合证券投资银行部，任投资银行业务线总监。主持或参与的 IPO 项目包括：盟升电子科创板 IPO 项目、沃特股份 IPO 项目、友邦吊顶 IPO 项目等；再融资项目包括：甬金股份可转债项目、富瀚微可转债项目、沃特股份非公开发行项目、华孚时尚非公开发行项目、方大特钢可转债项目、众信旅游可转债项目等；重大资产重组项目包

括：新宙邦发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、哈投股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目等。具有丰富的 IPO、再融资及并购重组业务经验。

牟晶先生，硕士，保荐代表人，供职于华泰联合证券投资银行部，任投资银行业务线执行总经理，2004 年开始从事投资银行业务。作为保荐代表人主持的项目包括：沃特股份 IPO 项目、乔治白 IPO 项目、华孚时尚非公开发行项目、美年健康非公开发行项目、蒙草生态非公开发行项目、新希望非公开发行项目等；主持或参与的其他项目包括：金安国纪、广日股份、TCL 集团、万科 A、七匹狼、株冶集团等融资项目；申银万国证券换股吸收合并宏源证券、潍柴动力换股吸收合并湘火炬等重组项目。具有丰富的 IPO、再融资及并购重组业务经验。

（二）项目协办人

本次锆威特首次公开发行股票项目的协办人为梁旭，其保荐业务执业情况如下：

梁旭先生，硕士，保荐代表人，中国注册会计师，任职于华泰联合证券投资银行部，任投资银行业务线副总监，2012 年加入普华永道，具有 4 年财务审计和尽职调查工作经历。2017 年开始从事投资银行业务。曾主持或参与的项目包括：孚日股份可转债项目、康泰医学 IPO 项目、三问家居 IPO 项目等，并参与数个 IPO 项目的辅导改制及再融资项目的论证和尽调工作。

（三）其他项目组成员

其他参与本次锆威特首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：刘华山、杜岩松。

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明

华泰联合证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书出具日：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

保荐机构将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司（以下简称“相关子公司”）参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。若相关子公司参与本次发行战略配售，相关子公司不参与询价过程并接受询价的最终结果，因此上述事项对本保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责不存在影响。

除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）保荐机构同意推荐苏州锴威特半导体股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（三）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，接受上海证券交易所的自律管理。

六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：

1、2022年1月21日，发行人召开了第一届董事会第十五次会议，该次会议应到董事9名，实际出席本次会议9名，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等议案。

2、2022年2月8日，发行人召开了2022年第一次临时股东大会，出席会议股东代表持股总数5,526.3158万股，占发行人股本总额的100%，审议通过了

《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等议案。

依据《公司法》《证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

七、保荐机构对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，及保荐机构的核查内容和核查过程的说明

华泰联合证券有限责任公司作为苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，为履行保荐机构职责，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法律法规的要求，对锴威特符合科创板定位要求审慎核查，具体情况如下：

（一）发行人符合科创板支持方向的核查情况

公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，主要产品包含功率器件及功率 IC 两大类。在功率器件方面，公司产品以高压平面 MOSFET 为主，并在平面 MOSFET 工艺平台基础上设计研发了集成快恢复高压功率 MOSFET（FRMOS）系列产品；在功率 IC 方面，公司专注于功率驱动 IC 和电源管理 IC。此外，在第三代半导体方面，公司的 SiC 功率器件已小批量出货。

公司是国家高新技术企业、国家鼓励的重点集成电路设计企业、江苏省“科技小巨人企业”“江苏省潜在独角兽企业”、江苏省半导体行业协会理事单位，公司研发中心获“江苏省高可靠性功率器件工程技术研究中心”认证。截至本上市保荐书出具日，公司已积累了 10 项核心技术，获得 50 项授权专利（其中发明专利 8 项，实用新型专利 42 项，另有 1 项发明专利已获授予专利通知书，待取得专利证书）和 32 项集成电路布图设计专有权。

凭借高性能的产品，公司荣获由中国电子信息发展研究院（赛迪研究院）评选的第十六届（2021 年度）和第十五届（2020 年度）“中国芯”优秀技术创新产品奖；由中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会等机构联合评选的第十四届（2019 年度）和第十二届（2017 年度）中国半导体创新产品和技术奖。公司还获得了汉磊科技“最佳合作伙伴”“最佳业绩成长”的合作商奖项，芯片设计和工艺调试能力得到业内知名晶圆代工厂的认可。

凭借产品可靠性高、参数一致性好等特点，公司迅速在细分领域打开市场，产品广泛应用于消费电子、工业控制及高可靠领域，客户包括以晶丰明源、必易微、芯朋微、灿瑞科技为代表的芯片设计公司等多家高可靠领域客户，并且产品已被小米、美的、雷士照明、佛山照明等终端客户所采用。

根据 Omdia 数据，按 2020 年收入规模测算，公司在全球 MOSFET 功率器件市场份额约为 0.23%。根据江苏省半导体行业协会统计，2020 年公司 FRMOS 产品国内市场占有率在本土企业中排名第四位。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”，是国家重点发展的战略性新兴产业之一，符合《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等有关政策，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条“科创板优先支持符合国家科技创新战略、拥有关键核心技术等先进技术、科技创新能力突出、科技成果转化能力突出、行业地位突出或者市场认可度高等的科技创新企业发行上市。”关于科创板支持方向的相关规定。

1、核查程序

（1）查阅发行人工商登记营业范围、经营范围，查阅《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）、《战略性新兴产业分类（2018）》等行业分类指引；

（2）调查发行人拥有的专利权证书、集成电路布图设计登记证书与获得荣誉证书等，分析发行人主要产品的核心技术，考察其技术水平、技术成熟程度、同行业技术发展水平及技术进步情况。

2、核查结论

经核查，公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条“科创板优先支持符合国家科技创新战略、拥有关键核心技术等先进技术、科技创新能力突出、科技成果转化能力突出、行业地位突出或者市场认可度高等的科技创新企业发行上市”关于科创板支持方向的相关规定。

(二) 发行人符合科创板行业领域要求的核查情况

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司的功率半导体芯片属于战略性新兴产业，是“新一代信息技术领域”中“半导体和集成电路、电子信息”等产业领域中的重要环节。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

1、核查程序

保荐机构查阅了《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《上市公司行业分类指引》（2012年修订）等政策文件，实地查看了发行人的生产经营场所，访谈了发行人管理层及研发、生产相关负责人，查阅了行业公开资料，了解了发行人业务及其所属行业领域，查阅了同行业可比公司的行业定位。

2、核查结论

经核查，保荐机构认为发行人所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定之“新一代信息技术领域”列示的科技创新企业，发行人主营业务与所属行业领域归类相匹配，与同行业公司的领域归类不存在显著差异。发行人不属于金融科技、模式创新企业，也不从事房地产和金融、投资类业务，符合《科创属性评价指引（试行）》第三条之规定。

(三) 发行人符合科创属性要求的核查情况

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2019年、2020年和2021年，发行人累计研发投入为4,045.81万元，累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为8.92%，在5%以上。
研发人员占当年员工总数的比例不低于10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至2021年12月31日，公司研发人员数量为32人，公司员工总数85人，占比为37.65%。
形成主营业务收入的发明专利(含国防专利) ≥ 5 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本上市保荐书出具日，发行人拥有境内外共8项发明专利。其中，形成主营业务收入的发明专利为7项，超过5项。
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2019年至2021年，发行人营业收入分别为10,667.95万元、13,698.04万元和20,972.89万元，复合增长率为40.21%，超过20%。

1、核查程序

(1) 针对发行人收入确认，保荐机构查阅公司大额销售合同、订单、出库单、签收单、银行回单、记账凭证等销售单据；执行函证程序；对重要客户进行访谈。针对研发投入情况，保荐机构对报告期内发行人的研发投入归集、研发项目工时表、研发费用分摊情况等进行了核查。保荐机构查阅了发行人的研发流程、研发机构设置，访谈相关负责人，了解发行人研发目标及研发方向。保荐机构复核了发行人研发投入的归集过程，查阅了发行人在研项目的立项情况，核查了发行人的研发项目、技术储备情况；

(2) 针对研发人员数量占比，保荐机构取得发行人的员工花名册及研发人员清单，查阅了发行人的研发项目工时表、研发流程、研发机构设置，访谈相关负责人。获取了发行人的员工社保、公积金缴纳记录；

(3) 针对发行人发明专利，取得发行人专利等证书，确认相关知识产权的权属归属及剩余期限，对于有无权利受限或诉讼纠纷进行核查；通过查询发行人所在地法院网站、裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等方式，核查发行人涉及诉讼、仲裁等情形；与公司研发部门负责人进行访谈，了解公司产品与

发明专利的匹配性及核心技术的运用，核查发明专利与主营业务收入的相关性；

(4) 针对发行人营业收入的复合增长情况，取得发行人财务报表及审计报告，访谈公司财务总监，对比了发行人同行业公司的收入变动情况，核查营业收入增长的原因和合理性。

2、核查结论

保荐机构经核查后认为：

(1) 发行人营业收入、研发费用真实，研发费用归集合理。2019 年至 2021 年，发行人累计研发投入为 4,045.81 万元，累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 8.92%，在 5% 以上。发行人符合科创属性评价标准一第一条规定。

(2) 发行人研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人研发人员数量为 32 人、员工总数 85 人，研发人员占当年员工总数的比例 37.65%。发行人符合科创属性评价标准一第二条规定。

(3) 发行人发明专利权属清晰，专利处于有效期内，专利无受限或诉讼纠纷。截至本上市保荐书出具日，发行人拥有境内外共 8 项发明专利，发行人形成主营业务收入的发明专利 7 项，形成主营业务收入的发明专利数量真实、准确。发行人符合科创属性评价标准一第三条规定。

(4) 发行人报告期内营业收入真实，2019 年至 2021 年，发行人营业收入分别为 10,667.95 万元、13,698.04 万元和 20,972.89 万元，复合增长率为 40.21%，超过 20%。发行人符合科创属性评价标准一第四条规定。

(四) 发行人符合科创板定位要求的结论性意见

综上，本保荐机构认为：发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和科创属性评价指引等规定要求，符合科创板定位要求。

八、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

1、发行人申请在上海证券交易所科创板上市，应当符合下列条件：

- (1) 符合中国证监会规定的发行条件；
- (2) 发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元；
- (3) 公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上；
- (4) 市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准；
- (5) 上海证券交易所规定的其他上市条件。

截至本上市保荐书出具日，发行人注册资本为 5,526.3158 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元；本次公开发行 1,842.1053 万股，本次发行后股本总额 7,368.4211 万元（不超过 4 亿元），公开发行股份的比例达到 25% 以上。发行人符合上述规定。

2、发行人申请在上海证券交易所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

(1) 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；

(2) 预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%；

(3) 预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

(4) 预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；

(5) 预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

根据大华会计师出具的《审计报告》（大华审字[2022]003305 号），发行人 2021 年度实现营业收入 20,972.89 万元，2021 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 4,389.76 万元。同时，考虑 A 股行业分类与发行人相同的企业在境内市场的估值情况以及发行人 2021 年 9 月份融资估值情况（增资对应发行人投后估值金额为 10.50 亿元）及 2021 年的业绩增长情况，预计发行人发行后市值不低于人民币 10 亿元。

因此，发行人符合上述第一套标准“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的要求。

综上，保荐机构认为发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

九、发行人表决权差异安排情况

截至本上市保荐书出具日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

十、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

持续督导事项	具体安排
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求。 2、确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其各项义务。 3、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。 4、持续关注上市公司对信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度的执行情况。
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	1、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务充分了解。 2、关注主要原材料供应或者产品销售是否出现重大不利变化；关注核心技术人员稳定性；关注核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可情况；关注主要产品研发进展；关注核心竞争力的保持情况及其他竞争者的竞争情况。 3、关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持上市公司股权被质押、冻结情况。 4、核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照上市规则规定履行核查、信息披露等义务	1、通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 2、关注上市公司股票交易情况，若存在异常波动情况，督促上市公司按照交易所规定履行核查、信息披露等义务。
4、对上市公司存在的可能	1、上市公司出现下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起

持续督导事项	具体安排
严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露。
5、定期出具并披露持续督导跟踪报告	1、在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内，披露持续督导跟踪报告。 2、上市公司未实现盈利、业绩由盈转亏、营业收入与上年同期相比下降 50% 以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。
6、持续督导期限	在本次发行结束当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。

十一、其他说明事项

无。

十二、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论

保荐机构华泰联合证券认为苏州锴威特半导体股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人： 梁旭
梁旭

保荐代表人： 薛峰 牟晶
薛峰 牟晶

内核负责人： 邵年
邵年

保荐业务负责人： 唐松华
唐松华

保荐机构总经理： 马骁
马骁

保荐机构董事长、法定代表人（或授权代表）： 江禹
江禹

保荐机构（公章）：华泰联合证券有限责任公司



2022年6月8日